

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2023-041

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,000 万元至 8,000 万元，同比下降 58.11%至 63.35%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6,500 万元至 7,300 万元，同比下降 57.57%至 62.22%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,000 万元至 8,000 万元，与上年同期相比，下降 58.11%至 63.35%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6,500 万元至 7,300 万元，与上年同期相比，下降 57.57%至 62.22%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润：19,098.82万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,204.44万元。

（二）每股收益：0.29 元。

三、本期业绩预降的主要原因

（一）在地缘政治博弈、贸易逆全球化背景下，全球经济发展面临越来越多的不确定性与挑战，市场预期与消费者信心低迷，使得以手机为代表的消费类电子市场需求持续不景气，行业同时还面临去库存和供应链重组的压力与困扰，对公司整体封装业务带来不利影响。虽然公司通过提前技术布局，受益于汽车智能化、网联化的产业发展趋势，持续发力车载摄像头封装、微型光学器件制造等新领域的开发拓展，相应业务规模与生产能力持续增强，但整体规模还有待进一步提升，上述原因使得报告期内公司整体营收与利润较去年同期下降。

（二）公司持续加大对创新技术、工艺的开发和研发投入，针对车规半导体，人工智能，AR/VR等不断变化的创新需求，聚焦车载摄像头封装、MEMS封装、微型光学器件、功率器件等方向持续加大研发投入力度与知识产权布局。

（三）公司持续推进国际先进技术与项目的协同整合，2022 年底进一步加大对以色列 VisIC 公司的投资以来，不断推进战略合作、业务协同与管理整合。VisIC 公司作为全球领先的第三代半导体 GaN（氮化镓）器件设计公司，正积极与国际知名汽车厂商合作，共同开发 800V 及以上高功率主驱动逆变器模块，为新型电动汽车提供更高转换效率，更小模块体积和更高可靠性的功率器件产品，由于其正处于产品开发与验证投入阶段，影响了公司的投资收益。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日